#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-281846

(43) Date of publication of application: 07.10.1994

~(51)Int.CI.

G02B 6/42 3/18

(21)Application number: 05-093598

H01S

(71)Applicant:

FURUKAWA ELECTRIC CO LTD:THE

(22)Date of filing:

29.03.1993

(72)Inventor:

**IKEGAMI YOSHIKAZU** 

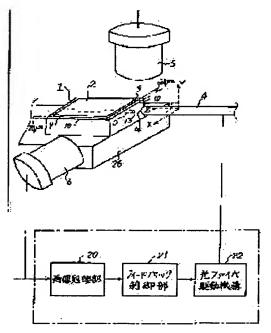
NAMIKI SHU

# (54) OPTICAL COUPLING METHOD FOR SEMICONDUCTOR LASER AND OPTICAL FIBER

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To easily and efficiently execute optical coupling of a semiconductor laser and an optical fiber.

CONSTITUTION: On the upper side of a sub-mount 26, a semiconductor laser 1 provided with a stripe light emitting part 3 in the inside is provided, and on the right above side of the semiconductor laser 1, an electrode 2 is provided. An optical fiber 4 is arranged so as to be opposed to a stripe emitting end 13 of the semiconductor laser 1, and image pickup cameras 5, 6 observing the stripe emitting end 13 side of the semiconductor laser 1 and an incident side tip 14 side of the optical fiber 4 are provided on the upper face side of the semiconductor laser 1, and the side face side being orthogonal thereto respectively. An image observed by the image pickup cameras 5, 6 is displayed on an image processing part 20, a deviation between an optical axis of the stripe light emitting part 3 and an optical axis of the optical fiber 4 core is detected, and based on its result, an optical fiber driving mechanism 22 is moved in the X and the Y directions under the control of a feedback control part 21, and a deviation of each optical axis is corrected. In such a way, a relative position of the semiconductor laser 1 and the core of the optical fiber 4 is adjusted, and optical coupling of the semiconductor laser 1 and the optical fiber 4 is executed.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

28.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision

of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3303418

[Date of registration]

10.05.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-281846

(43)公開日 平成6年(1994)10月7日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 6/42 H01S 3/18 9317-2K

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平5-93598

(22)出顧日

平成5年(1993)3月29日

(71)出願人 000005290

古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

(72)発明者 池上 嘉一

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古

河電気工業株式会社内

(72)発明者 並木 周

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古

河電気工業株式会社内

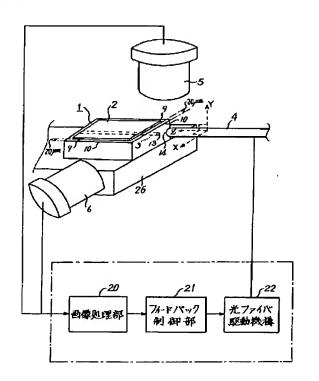
(74)代理人 弁理士 五十嵐 清

# (54) 【発明の名称】 半導体レーザと光ファイバとの光学的結合方法

# (57)【要約】

【目的】 半導体レーザと光ファイバとの光学的結合を 容易に、効率的に行う。

【構成】 サブマウント26の上側に、内部にストライプ 発光部3を備えた半導体レーザ1を設け、半導体レーザ 1の直上側には電極2を設ける。光ファイバ4を半導体 レーザ1のストライプ出射端13に対向配置し、半導体レ ーザ1のストライプ出射端13側と光ファイバ4の入射側 先端14側を観察する撮像カメラ5、6を、半導体レーザ 1の上面側と、それと直交する側面側に設ける。撮像カ メラ5.6で観察した画像を画像処理部20に表示し、ス トライプ発光部3の光軸と光ファイバ4コアの光軸のず れを検出し、その結果に基づき、フィードバック制御部 21の制御により光ファイバ駆動機構22をX, Y方向に移 動させ、各光軸のずれを修正する。このようにして半導 体レーザ1と光ファイバ4のコアとの相対位置を調整 し、半導体レーザ1と光ファイバ4との光学的結合を行



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体レーザのストライブ出射端側に対 向配置する光ファイバを光軸のZ軸方向とこのZ軸に対 して直交するX軸およびY軸方向に移動する駆動機構に 連係しておき、半導体レーザの出射端側のストライプ発 光部と光ファイバのコアを半導体レーザの上面側とこれ に直交する側面側の2方向から撮像カメラによって観察 し、各撮像カメラの画像を用いてストライプ発光部と光 ファイバコアのX軸方向とY軸方向のずれを検出し、こ のずれを修正するX、Y方向に駆動機構を移動して半導 10 体レーザと光ファイバコアとの相対位置を調整する半導 体レーザと光ファイバとの光学的結合方法。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば、半導体モジュ ールの作製の際に行われる、半導体レーザと光ファイバ との光学的結合方法に関するものである。

## [0002]

【従来の技術】光半導体モジュールの作製等の際には、 半導体レーザと光ファイバの光学的結合を行う必要があ 20 る。半導体レーザと光ファイバの光学的結合は、図3に 示すように、まず、半導体レーザ1を駆動させ、ストラ イブ出射端13から半導体レーザ1の光を発振出射させ、 半導体レーザ1の上側に設けられた撮像カメラ5で観察 しながら光ファイバ4の入射側の先端14をストライプ出 射端13と一定の距離Aを介して近づけ、光ファイバ4の コアに半導体レーザ1の光を入射する。次に、光ファイ バ4の出射側の端面15に接続されている受光検出モニタ 16により、光ファイバ4のコアから出射される光の強度 4の入射側の先端14側を移動する。そのことにより、半 導体レーザ1と光ファイバ4コアの光軸2を合わせ、半 導体レーザ1と光ファイバ4の相対位置を調整し、半導 体レーザ1と光ファイバ4との光学的結合を行ってき た。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、半導体 レーザ1と光ファイバ4のコアとの相対位置が光ファイ バのトレランス(最適位置からのずれの許容範囲)から ずれている場合は、半導体レーザ1のストライプ発光部 40 3の光を光ファイバ4のコアに少しでも入射させること ができず、特に、光ファイバ4がシングルモードファイ バの場合は、光ファイバのトレランスは数μπと小さい ために、半導体レーザ1のストライプ発光部3の光が光 ファイバ4のコアに入射する位置に光ファイバ4の入射 側先端14側を移動させることは困難だった。

【0004】また、半導体レーザ1のストライプ発光部 3の光が光ファイバ4のコアに入射する位置に光ファイ バ4の先端14側を移動させた後も、受光検出モニタ16亿 より検出される光ファイバ4の出射光の強度が最適値と 50 は、本発明に係る半導体レーザと光ファイバとの光学的

なるように光ファイバ4の先端14側を移動し、半導体レ ーザ1と光ファイバ4の相対位置を調整するには時間が かかり、特に、半導体レーザ1と光ファイバ4の相対位 置が最適位置から大きくずれていた場合などは、受光検 出モニタ16で検出される光ファイバ4出射光の最適ビー クを捜すには非常に時間がかかった。

【0005】また、光半導体モジュール作製等の目的で 半導体レーザ1と光ファイバ4の相対位置を最適位置に て固定する場合に、半導体レーザ1と光ファイバ4の相 対位置を最適位置に調整した後、位置を固定する前に、 何らかの原因でその位置がずれてしまったりすると、そ のずれの方向をすぐに検出する手段がないために半導体 レーザ1と光ファイバ4の相対位置の調整を最初からや り直さなければならず、2度手間となり、非効率的であ った。また、段差のある物を微小な距離を隔てて精密に 置くことは、ピントが合わないので難しい。

【0006】本発明は上記従来の課題を解決するために なされたものであり、その目的は、半導体レーザと光フ ァイバとの光学的結合を容易にし、効率的に行える半導 体レーザと光ファイバとの光学的結合方法を提供すると とにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は次のように構成されている。すなわち、本 発明は、半導体レーザのストライブ出射端側に対向配置 する光ファイバを光軸の乙軸方向とこの乙軸に対して直 交するX軸およびY軸方向に移動する駆動機構に連係し ておき、半導体レーザの出射端側のストライプ発光部と 光ファイバのコアを半導体レーザの上面側とこれに直交 を測定し、この光強度が最適値となるように光ファイバ 30 する側面側の2方向から撮像カメラによって観察し、各 撮像カメラの画像を用いてストライプ発光部と光ファイ バコアのX軸方向とY軸方向のずれを検出し、このずれ を修正するX、Y方向に駆動機構を移動して半導体レー ザと光ファイバコアとの相対位置を調整することを特徴 として構成されている。

#### [0008]

【作用】上記構成の本発明において、半導体レーザのス トライプ出射端側のストライプ発光部と光ファイバのコ アは、半導体レーザの上面側とこれに直交する側面側の 2方向から撮像カメラによって観察される。各撮像カメ ラの画像は画像処理部に表示され、この表示によりスト ライプ発光部と光ファイバのコアのX軸方向とY軸方向 のずれは検出される。この検出結果に基づいて、ずれを 修正するX、Y方向に駆動機構を移動することで半導体 レーザと光ファイバコアとの相対位置が調整される。

## [0009]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明 する。なお、本実施例の説明において、従来と同一部分 には同一符号を付し、その重複説明は省略する。図1に

結合方法に用いる装置の一実施例が示されている。図1 において、サブマウント26の上側には直方体状の半導体 レーザ1が搭載され、ボンディングされており、半導体 レーザ1の直上側には電極2がボンディングされてい る。電極2の外周縁9と半導体レーザ1の上面の外周縁 10との間の距離は20µmあり、その分だけ電極2の面積 は半導体レーザ1の上面の面積よりも小さくなってい る。

【0010】半導体レーザ1の内部にはストライプ発光 部3が設けられており、ストライプ発光部3は半導体レ ーザ1駆動時に発光する光により、半導体レーザ1の外 側から半導体レーザーの鏡面状態となっている外周面を 通して透けて見えるようになっている。

【0011】半導体レーザ1のストライプ出射端13側に は光ファイバ4が対向配置されており、光ファイバ4は 光ファイバ駆動機構22に連係され、その光ファイバ駆動 機構22により光ファイバ4の光軸 2方向、及びそれに直 交するX、Y方向に自在に移動できるように構成されて いる。光ファイバ4は先球のシングルモードファイバで あり、そのコアの先端側はテーパ状になっている。

【0012】半導体レーザ1の上面側(図のY方向)に は赤外線カメラである撮像カメラ5が設けられており、 半導体レーザ1のストライプ発光部3と光ファイバ4を 上面側から撮像できるようになっている。また、半導体 レーザ1の上面側を直交する側面手前側(図のX方向) には赤外線カメラの撮像カメラ6が設けられており、撮 像カメラ5と同様に、半導体レーザ1のストライプ発光 部3と光ファイバを側面側から観察し、撮像できるよう になっている。

【0013】撮像カメラ5,6は画像処理部20に接続さ れ、画像処理部20はフィードバック制御部21に接続され ている。画像処理部20は撮像カメラ5,6で撮像した各 画像を同一の画面に同時に表示し、ストライプ発光部3 と光ファイバ4コアのX軸方向とY軸方向のずれを検出 する働きをしている。フィードバック制御部21は前記光 ファイバ駆動機構22に接続されていて、フィードバック 制御部21は、画像処理部20により検出されたストライプ 発光部3と光ファイバ4コアのX軸方向とY軸方向のず れを修正する方向に、光ファイバ駆動機構22を移動させ る働きをしている。

【0014】以上のように本実施例は構成されており、 次にその動作について説明する。まず、半導体レーザ1 を駆動し、半導体レーザ1のストライプ発光部3からレ ーザ光を発光させる。次に、撮像カメラ5, 6のピント をそれぞれストライプ発光部3に合わせ、撮像カメラ 5,6の各画像を画像処理部20の画面に映し出す。

【0015】画像処理部20の画面には、図2に示すよう に、撮像カメラ5, 6の各画像が同一画面に同時に表示 される。画面の上側半面には撮像カメラ5によって撮像 された、半導体レーザ1のストライプ出射端13側と光フ 50 に知ることができ、それにより、すぐにずれを修正する

ァイバ4の入射側先端14側のXZ平面の画像(上面側か ら見た画像)が表示され、画面の下側半面には撮像カメ ラ6によって撮像された、半導体レーザ1のストライプ 出射端13側と光ファイバ4の入射側先端14側のYZ平面 の画像(側面側から見た画像)が表示される。

【0016】次に、光ファイバ駆動機構22を作動させ、 光ファイバ4を 2軸方向に移動させ、画像処理部20の画 面を見ながら光ファイバ4の先端14と半導体レーザ1の ストライプ出射端13との距離が10μmとなるように、光 ファイバ4の入射側の先端14側を半導体レーザ1のスト ライブ出射端13に近づける。

【0017】次に、半導体レーザ1のストライプ発光部 3の光軸23と光ファイバ4のコア12の光軸24のずれを画 像処理部20により検出し、検出結果の信号をフィードバ ック制御部21に伝送する。

【0018】フィードバック制御部21は画像処理部20か ら送られた信号に基づき、半導体レーザ1のストライプ 発光部3の光軸23と光ファイバコア12の光軸24とのずれ を修正するXY方向に光ファイバ駆動機構22を移動させ 20 る。この移動によりストライプ発光部3と光ファイバコ ア12の各光軸23、24が一致し、ストライプ発光部3の光 がコア12の中心に入射するような方向に光ファイバ4が 移動する。このようにして半導体レーザ1と光ファイバ コア12との相対位置を調整し、半導体レーザ1と光ファ イバ4の光学的結合を行う。

【0019】以上のように、本実施例によれば、撮像カ メラ5、6により半導体レーザ1のストライプ発光部3 と光ファイバ4のコア12を半導体レーザ1の上面側と側 面側の2方向から観察して撮像し、撮像した画像を画像 処理部20により同一画面上に同時に映し出して、半導体 レーザ1のストライプ発光部3の光軸23と光ファイバ4 のコア12の光軸24のずれを検出するため、光軸23と光軸 24のX方向とY方向のずれを同時に検出することができ る。したがって、各光軸23、24のずれを検出するために 要する信号処理の時間も短くてすみ、短時間で各光軸2 3,24のずれを検出することができる。

【0020】また、その検出結果に基づき、フィードバ ック制御部21は各光軸23、24のずれが修正されるように 光ファイバ駆動機構22を移動させ、光ファイバ4を移動 40 することにより、容易に光ファイバ4のコア12の光軸24 を半導体レーザ1のストライプ発光部3の光軸23と一致 させることができる。したがって、従来例のように、半 導体レーザーと光ファイバコア12との相対位置の調整に 時間がかかることなく、短時間で調整することができ

【0021】また、半導体レーザ1と光ファイバコア12 との相対位置の調整後、光ファイバ4を固定する際に、 何らかの原因で光ファイバ4の位置が微妙にずれた場合 にも、撮像カメラ5、6の観察によりずれた方向を即座

ことができるため、半導体レーザ1と光ファイバコア12 との位置ずれの修正も効率良く行うことができる。

【0022】また、半導体レーザ1のストライプ出射端 13を光ファイバ4の入射側の先端14側を近づける時に も、撮像カメラ5、6により2方向から観察することが できるために、ストライプ出射端13と光ファイバ4の入 射側の先端14側との距離を正確に測定することができ、 そのための操作も容易に行うことができる。

【0023】なお、本発明の構成は上記実施例に限定さ れることはなく、様々な実施の態様を採り得る。例え ば、上記実施例で用いた光ファイバ4は先球のシングル モードファイバであり、そのコア12は先端側がテーパ状 になっていたが、光ファイバ4はマルチモードファイバ でもよく、その形状も先球光ファイバとは限らず、コア 12の先端側がテーバ状になっているもの以外の光ファイ バ4を用いた場合にも本発明を適用させることができ る。但し、本実施例で用いたシングルモードファイバ4 は非常に極細であり、半導体レーザ1との光結合の位置 合わせが特に難しい光ファイバであるので、このような 光ファイバ4の光結合を容易に短時間で行える本発明に 20 よれば、光ファイバ4の種類や形状を変えた場合にも、 より容易に短時間で半導体レーザ1との光結合を行うと とができる。

【0024】また、上記実施例では、半導体レーザ1の 上面の外周縁10と電極2の外周縁9との間の距離を20μ mとしたが、この距離は20μm以上であればよく、電極 2の面積が電極2としての機能を果たす大きさであれ ば、電極2の外周縁9と半導体レーザ1の上面の外周縁 10の距離は大きく隔ててあっても構わない。

【0025】さらに、上記実施例では、撮像カメラ6を 30 ができる。 半導体レーザ1の上面側と直交する側面手前側に設けた が、撮像カメラ6は半導体レーザ1の上面側と直交する 側面で半導体レーザ1の奥側に設けるように構成しても よい。

【0026】また、上記実施例では、半導体レーザ1は サブマウント26に搭載し、ボンディングされていたが、 半導体レーザ1はサブマウント26に搭載されているとは 限らず、ステム等に搭載されていてもよいし、搭載され た後にボンディングされていなくてもよく、例えば半田 等により実装されていてもよい。

【0027】さらに、上記実施例では、撮像カメラ5. 6の画像を画像処理部20亿表示し、フィードバック制御 部21の制御により光ファイバ駆動機構22を駆動、制御し ていたが、フィードバック制御部21は必ずしも設ける必 要はなく、画像処理部20の表示に従い、手動により光フ ァイバ駆動機構22を駆動させてもよい。

【0028】さらにまた、上記実施例では、撮像カメラ 5,6の画像を画像処理部20で同一の画面に同時に表示 したが、同一の画面にスイッチの切り換え等により別々 に表示するように構成してもよく、また、撮像カメラ5 用と撮像カメラ6用との別々の画面を設けて表示しても よい。但し、これらの場合は、半導体レーザ1のストラ イプ発光部3の光軸23と光ファイバ4のコア12の光軸24 とのずれを検出するために行われる信号処理の時間は、 10 撮像カメラ5、6の画像を同一画面に同時に表示する場 合に比べると多少長くかかる。

[0029]

【発明の効果】本発明によれば、半導体レーザの上面側 とこれに直交する側面側の2方向から撮像カメラによっ て観察し、各撮像カメラの画像を用いてストライプ発光 部と光ファイバコアのX軸方向とY軸方向のずれを検出 するため、このずれは容易に短時間で検出することがで きる。また、との検査結果に基づき、このずれを修正す るX、Y方向に駆動機構を移動して半導体レーザと光フ ァイバコアとの相対位置を調整するため、調整は容易 で、調整にかかる時間は短時間ですむ。

【0030】また、半導体レーザと光ファイバを固定す る際に、一度半導体レーザと光ファイバコアとの相対位 置を調整した後に、固定前にその位置が微妙にずれた時 には撮像カメラによってそのずれを即座に検出し、すぐ にずれを修正することができる。したがって、本発明を 用いることにより、半導体レーザと光ファイバとの光学 的結合を容易に、効率的に行うことができ、光半導体モ ジュールの作製等の際にも組立の時間を大幅に省くこと

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る半導体レーザと光ファイバの光学 的結合に用いる装置の一実施例を示すブロック構成図で ある。

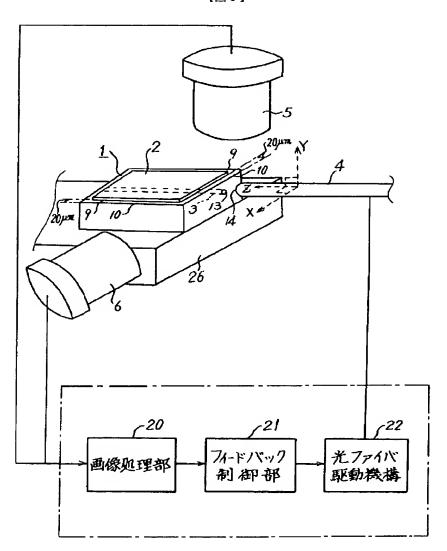
【図2】上記装置の画像処理部の画面に映し出された撮 像カメラの画像を示す説明図である。

【図3】半導体レーザと光ファイバの従来の光学的結合 方法を示す説明図である。

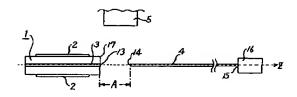
【符号の説明】

- 40 1 半導体レーザ
  - 2 電極
  - 3 ストライプ発光部
  - 4 光ファイバ
  - 5,6 撮像カメラ
  - 12 コア

[図1]



【図3】



[図2]

